

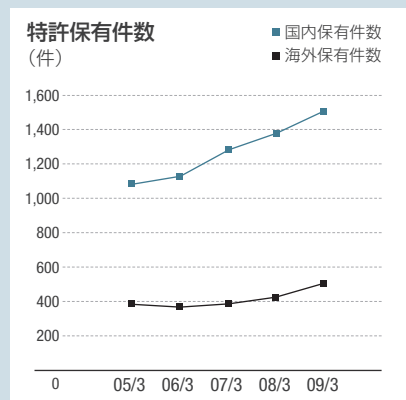
エネルギーや情報を「伝える」技術をもとに、時代に先駆けた研究開発を推進します

時代に先駆けた研究開発

当社グループは、エネルギーや情報を「伝える」というコア技術をベースに、顧客のニーズに的確に応えていくための研究開発に注力しています。研究開発体制は、技術本部（技術研究所）と事業本部の開発部門で構成しており、両部門が連携して国内外の市場・技術動向の把握や研究開発スタッフの育成に努めながら、時代に先駆けたスピーディな技術・製品の開発を進めています。

知的財産権の戦略的な活用

研究開発や製品開発から生まれた特許権などの知的財産権は、事業戦略上の重要な経営資源です。当社は、特許権の数とともに質の充実にも努め、これらを権利として適正に取得し、有効に活用することにより事業優位性を確保していきます。



2009年3月期の研究開発の成果

2009年3月期における当社グループの事業セグメント別の研究開発項目及びその成果は、以下のとおりです。なお、2009年3月期の研究開発費は110億78百万円でした。

電線・ケーブル事業

当セグメントでは、産業用電線・ケーブルや、電子機器に関連する伝送、接続技術の研究開発に取り組んでいます。なお、当セグメントに係る研究開発費は、15億円でした。

<成果>

- ・ITER(国際熱核融合実験炉)用TF(トロイダル磁場)コイル燃線の量産体制の確立
- ・医療機器用超極細導体の開発

情報通信ネットワーク事業

当セグメントでは、光ファイバケーブルをはじめ、情報通信に関連するケーブル、センサや、インターネットや携帯電話のシステム構築に必要な各種デバイス、コンポーネント、さらにはネットワーク機器及び携帯電話基地局アンテナなどの研究開発を行っています。なお、当セグメントに係る研究開発費は、52億86百万円でした。

<成果>

- ・集合型メディアコンバータ用のイーサネットOAM(保守・管理用国際標準規格)対応ラインカードの開発
- ・Apresia16000シリーズの開発
- ・ボックス型レイヤー2/レイヤー3対応スイッチングハブ(Apresia3400シリーズ)の製品化

高機能材料事業

当セグメントでは、主に次の3つの分野において研究開発を行っています。なお、当セグメントに係る研究開発費は、42億92百万円でした。

<成果>

- ◇半導体パッケージ材料・電子部品分野
 - ・配線リードピッチ25μmのCOF(Chip On Film)テープの量産化
- ◇伸銅品分野
 - ・高放熱小型パッケージ用異形銅条の開発
 - ・空調用銅管の開発
- ◇自動車用部品分野
 - ・ハイブリッド電気自動車用ノンハロゲン150℃耐熱電源ハーネスの開発

